

2023年3月期

第2四半期決算説明

2022年11月9日

芝浦メカトロニクス株式会社

目次

- 1. 2023年3月期 第2四半期業績**
2. 2023年3月期 業績予想
3. 中期経営計画の進捗

業績サマリー

■ 売上高・利益

- 対前年 増収増益
- 売上高は計画どおりに推移し、293億円
- 営業利益は前年比2.5倍の 46.0億円
- 当期純利益は前年比4.5倍の 34.1億円
- ROSは半期で過去最高の 15.7%

■ 受注高

- SPE分野が好調に推移し、前年比1.6倍の 474億円

業績結果 (対前年)

増収増益、ROS15.7%

【連結】

単位：億円

	21/上	21/下	22/上 実績	対前年 増減率
売上高	219	274	293	+33%
営業利益	18.5	32.0	46.0	+149%
R O S	8.4%	11.9%	15.7%	+7.3pt
経常利益	17.5	31.3	42.6	+144%
特別損失	6.1	-	-	-
当期純利益	7.5	22.3	34.1	+354%
受注高	293	415	474	+62%
F C F	30.8	47.1	43.8	+13.0億円

業績結果まとめ (対前年) ①

* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

- 売上高 前年比33%増収 (219億円 ⇒ 293億円)
 - SPE分野、FPD分野とも増加し、増収
- 営業利益 前年比149%増益 (18.5億円 ⇒ 46.0億円)
 - SPE分野の売上増加と利益率の改善により、営業利益は増益
- 当期純利益 前年比354%増益 (7.5億円 ⇒ 34.1億円)
 - 営業利益の改善が寄与し当期純利益は増益。
- 受注高 前年比62%増加 (293億円 ⇒ 474億円)
 - SPE分野が好調に推移、FPD分野は減少したが、全体として増加

業績結果まとめ (対前年) ②

■ ファインメカトロニクス部門

* ファインメカトロニクス部門：半導体/FPD前工程装置

- **売上高** 前年比35%増 (137億円 ⇒ 186億円)
半導体前工程では、ロジック/ファウンドリ向けやパワーデバイス向け、ウェーハ向けが堅調で増加。
FPD前工程では、前年度受注低調の影響などで横ばい。
- **セグメント利益** 前年比257%増 (9.0億円 ⇒ 32.0億円)
半導体前工程の売上増加などにより大幅増益。
- **受注高** 前年比92%増 (187億円 ⇒ 358億円)
半導体前工程では、ウェーハ向けを中心に好調に推移。
FPD前工程では、大型・中小型パネル向けとも低水準で推移。
ヘルスケア分野のインクジェット錠剤印刷装置で受注継続。

業績結果まとめ（対前年）③

■ メカトロニクスシステム部門

*メカトロニクスシステム部門：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

- **売上高** 前年比39%増（62億円 ⇒ 86億円）
半導体後工程では、先端パッケージ向けやFO-PLP向けが堅調に推移。
FPD後工程では、TV・モニタ用途の大型パネル向けが堅調で増加。
真空部門では、電子部品向けや半導体向けが増加。
- **セグメント利益** 前年比61%増（9.3億円 ⇒ 15.0億円）
売上増加などにより増益。
- **受注高** 前年比10%増（87億円 ⇒ 95億円）
半導体後工程では、2.5Dなど先端パッケージ向けを中心に堅調に推移。
FPD後工程では、モニタ用パネル向け・車載用パネル向けで受注獲得、大型TV向けは顧客の投資計画延期。
真空部門では、電子部品向けや半導体向けが堅調に推移。

業績結果 (対前回見通し)

【連結】

*1: 2022年8月公表
単位：億円

	22/上		
	前回見通し *1	実績	対前回見通し 増減率
売上高	280	293	+4%
営業利益	37.0	46.0	+24%
R O S	13.2%	15.7%	+2.5pt
経常利益	35.0	42.6	+22%
特別損失	-	-	-
当期純利益	28.0	34.1	+22%
受注高	-	474	-

業績結果まとめ（対前回見通し）

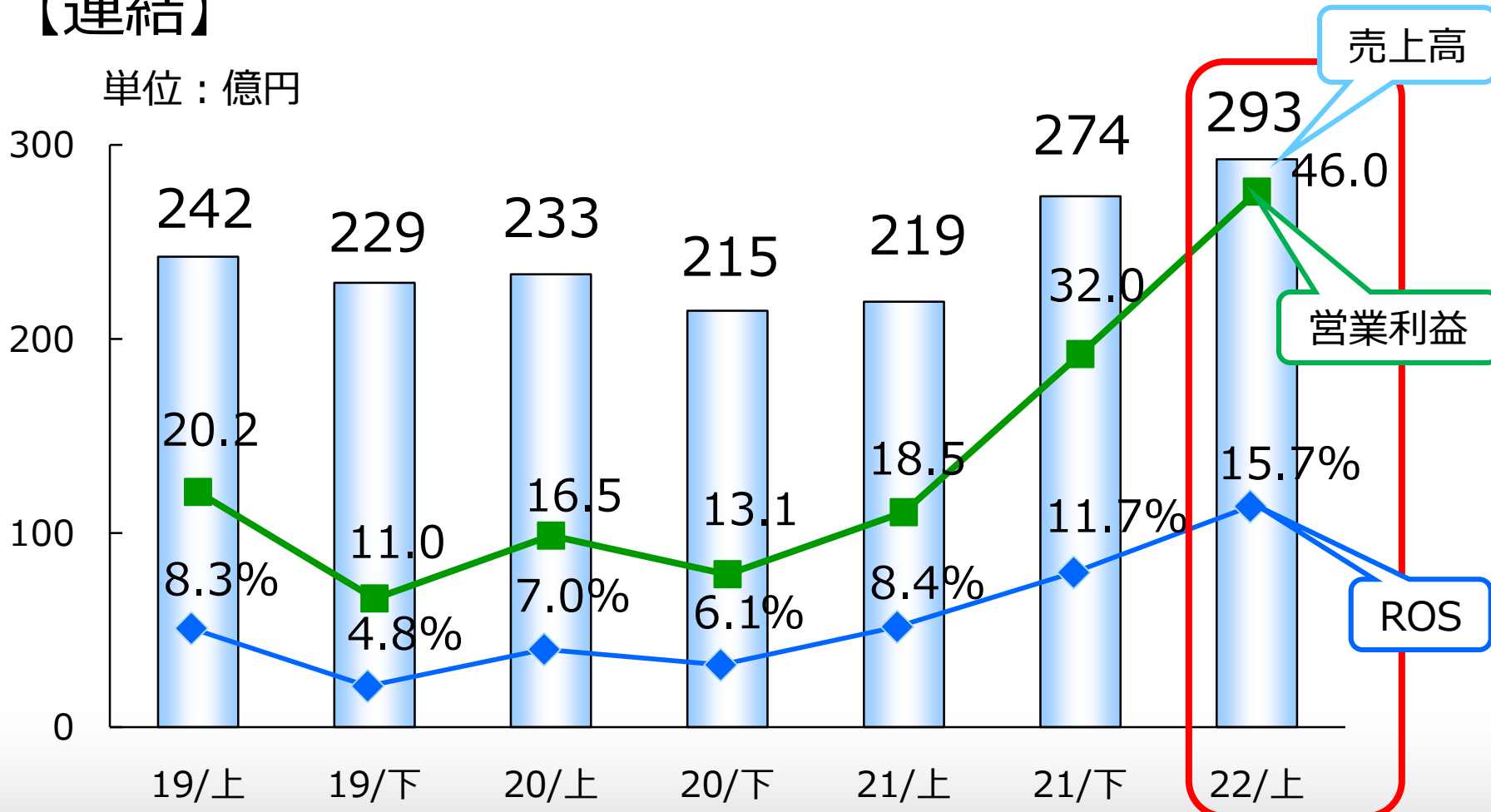
- 売上高 前回見通し比4%増収（280億円 ⇒ 293億円）
 - SPE分野の増加で増収
- 営業利益 前回見通し比24%増益（37.0億円 ⇒ 46.0億円）
 - SPE分野の売上増加と利益率の改善、経費抑制により、営業利益は改善
- 当期純利益 前回見通し比22%増益（28.0億円 ⇒ 34.1億円）
 - 営業利益改善により当期純利益は増益

売上高・利益・ROS

SPE分野が増加しROS15.7%

【連結】

単位：億円



セグメント別売上高

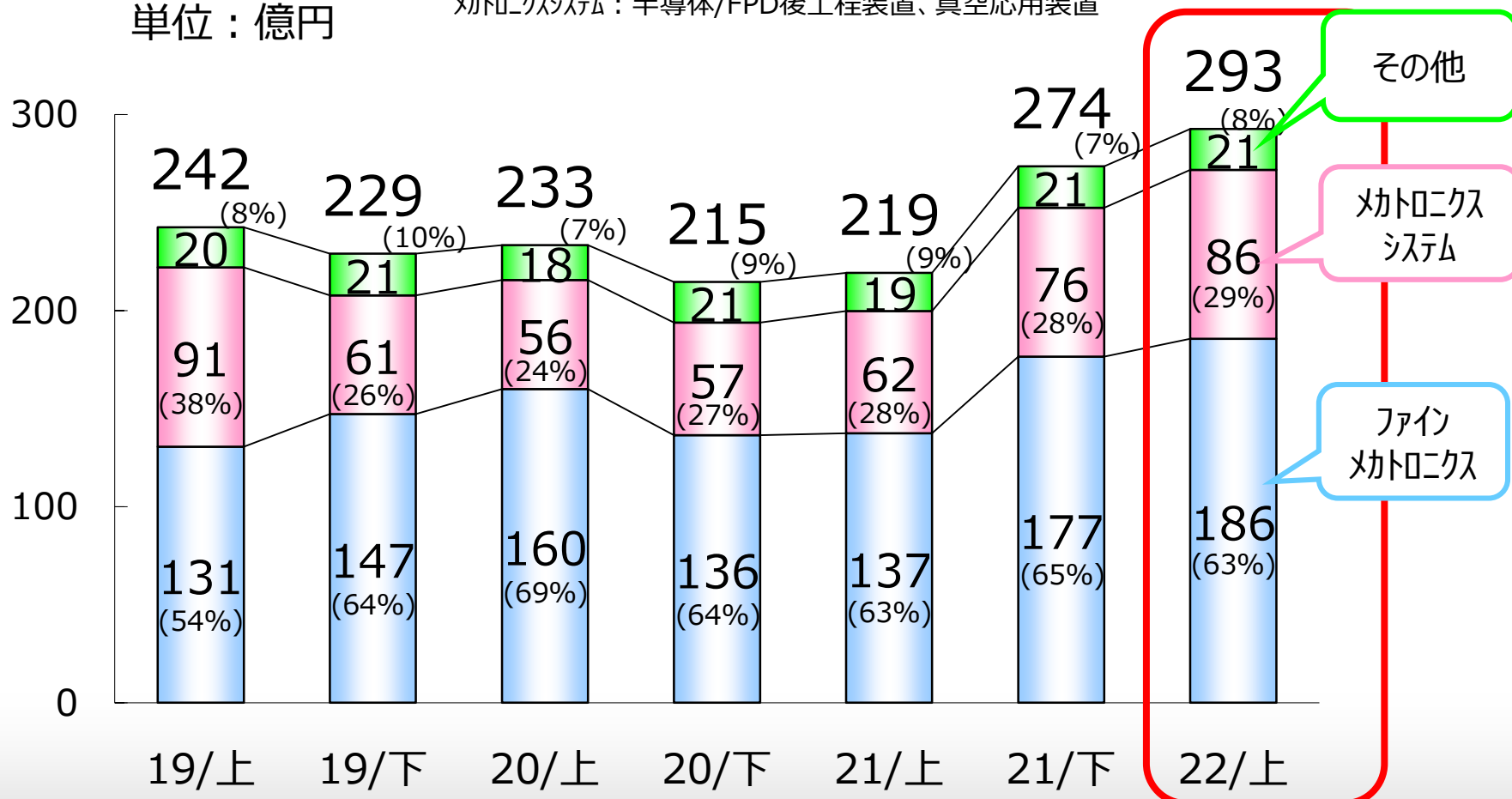
ファインメカトロニクスが63%

【連結】

単位：億円

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

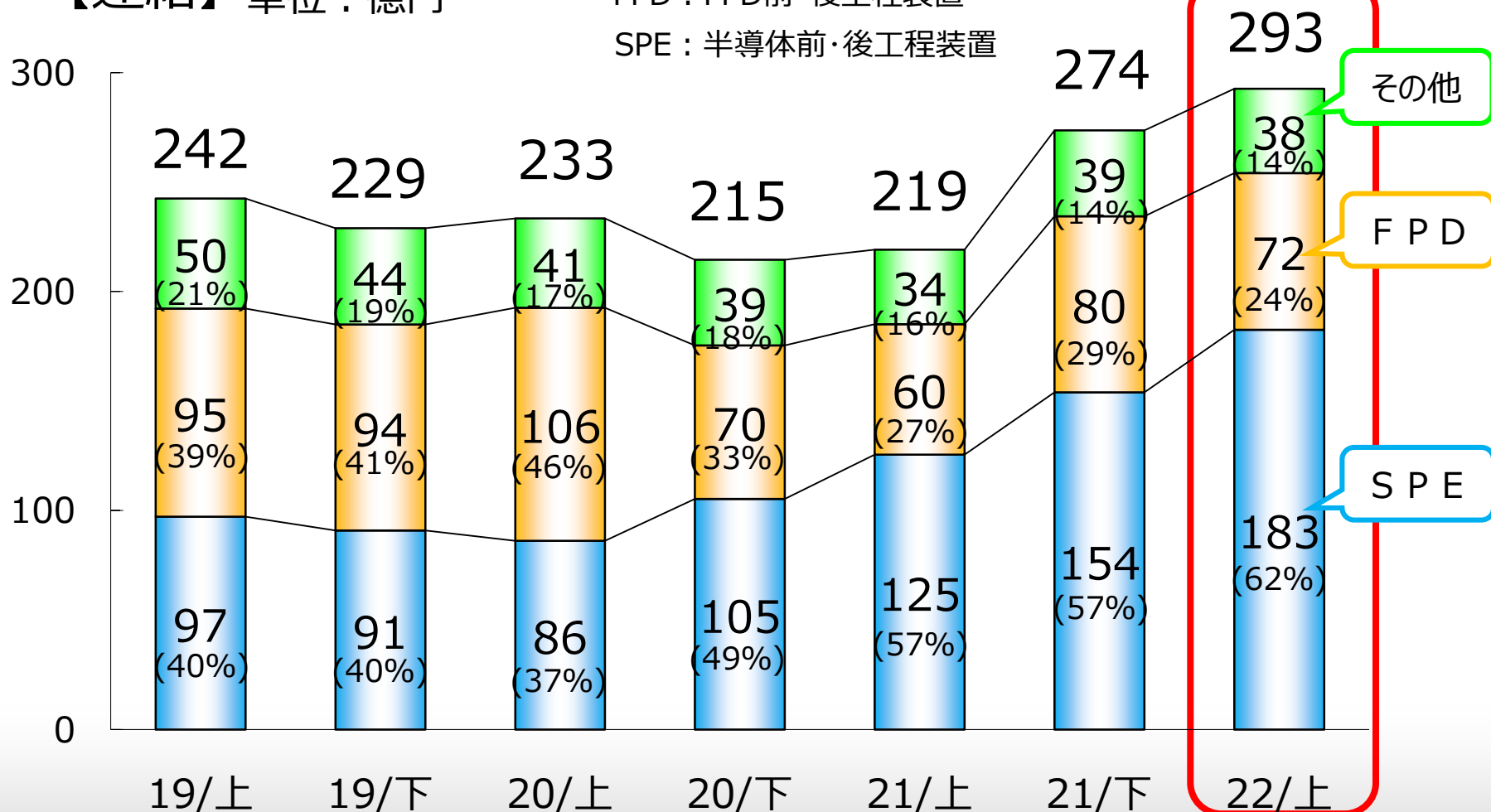


分野別売上高

SPE分野が62%に増加

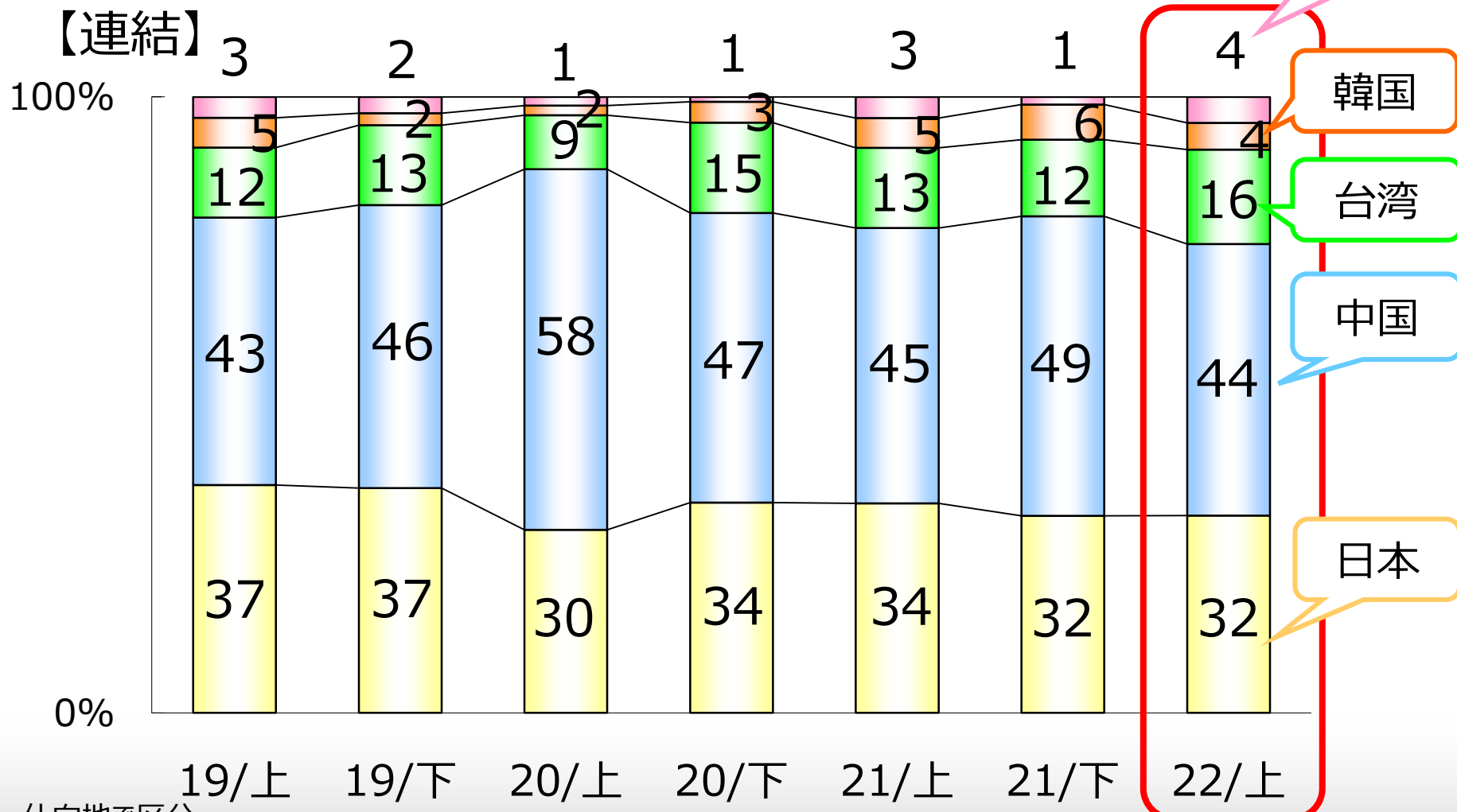
【連結】 単位：億円

* FPD：FPD前・後工程装置
SPE：半導体前・後工程装置



地域別売上高比率

海外向け68% (中国44%)



* 仕向地で区分

セグメント別受注高

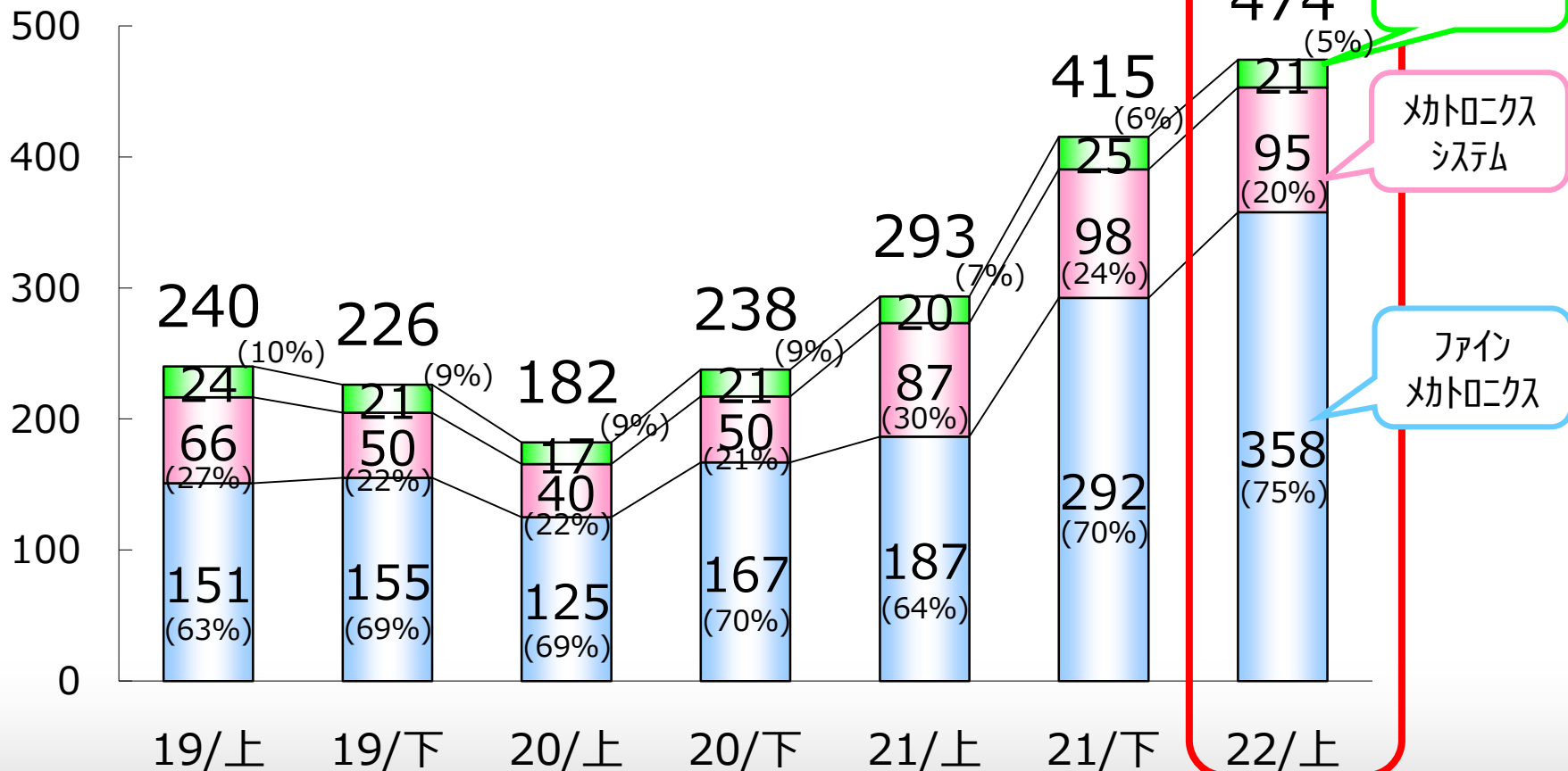
ファインメカトロニクスが75%

【連結】

* ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置

メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

単位：億円



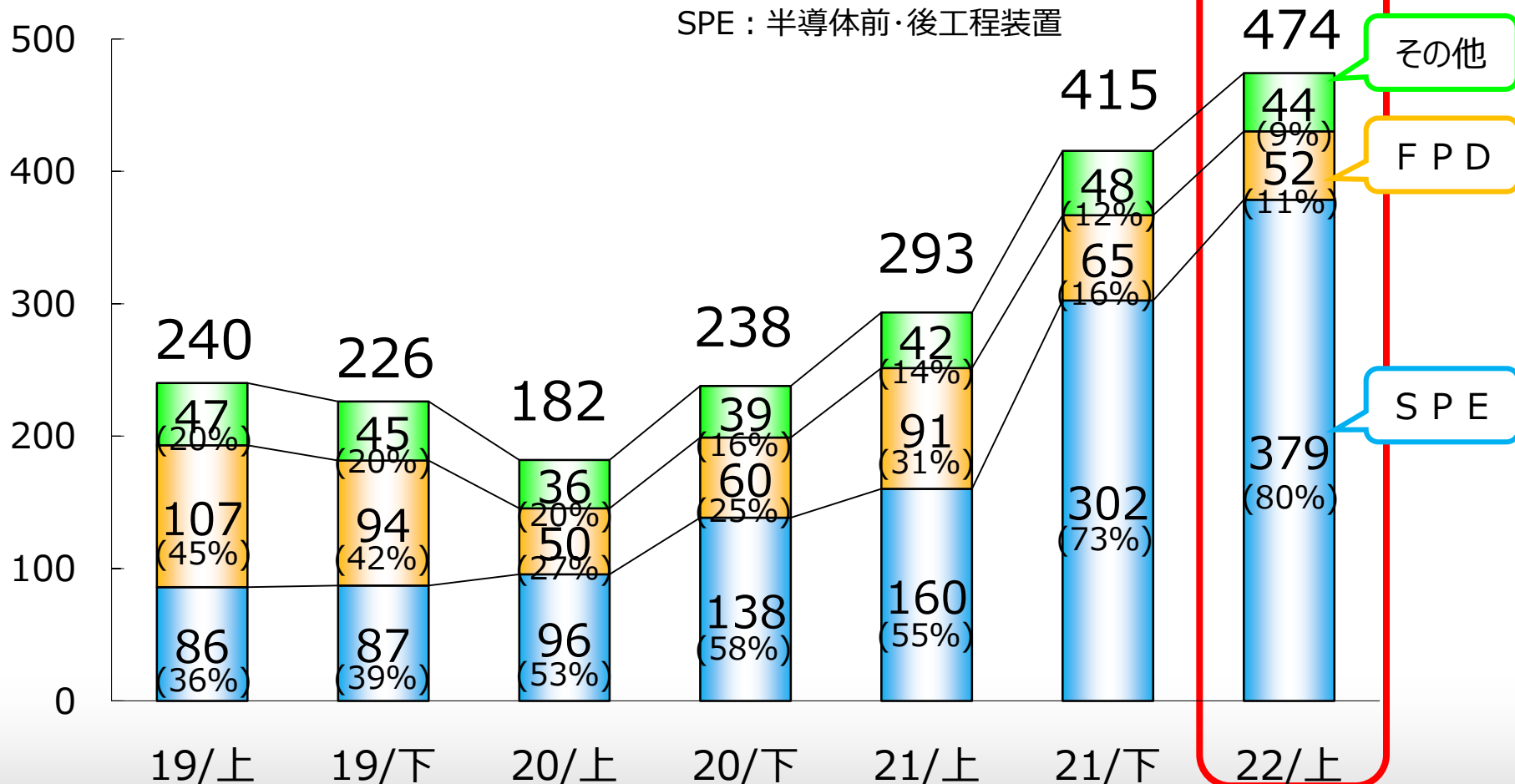
分野別受注高

SPE分野が増加し80%

【連結】 単位：億円

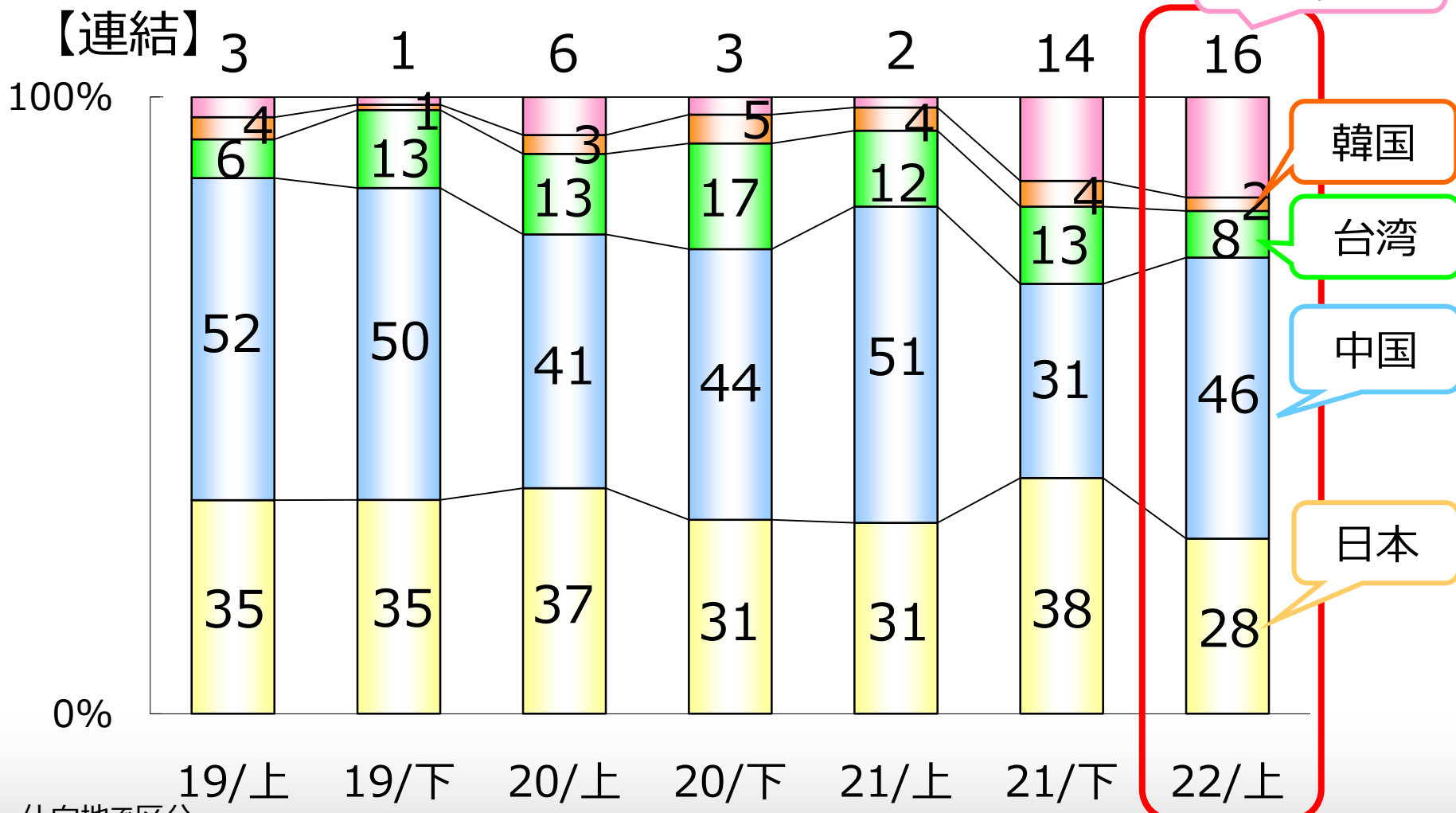
* FPD：FPD前・後工程装置

SPE：半導体前・後工程装置



地域別受注高比率

海外向け72% (中国46%)

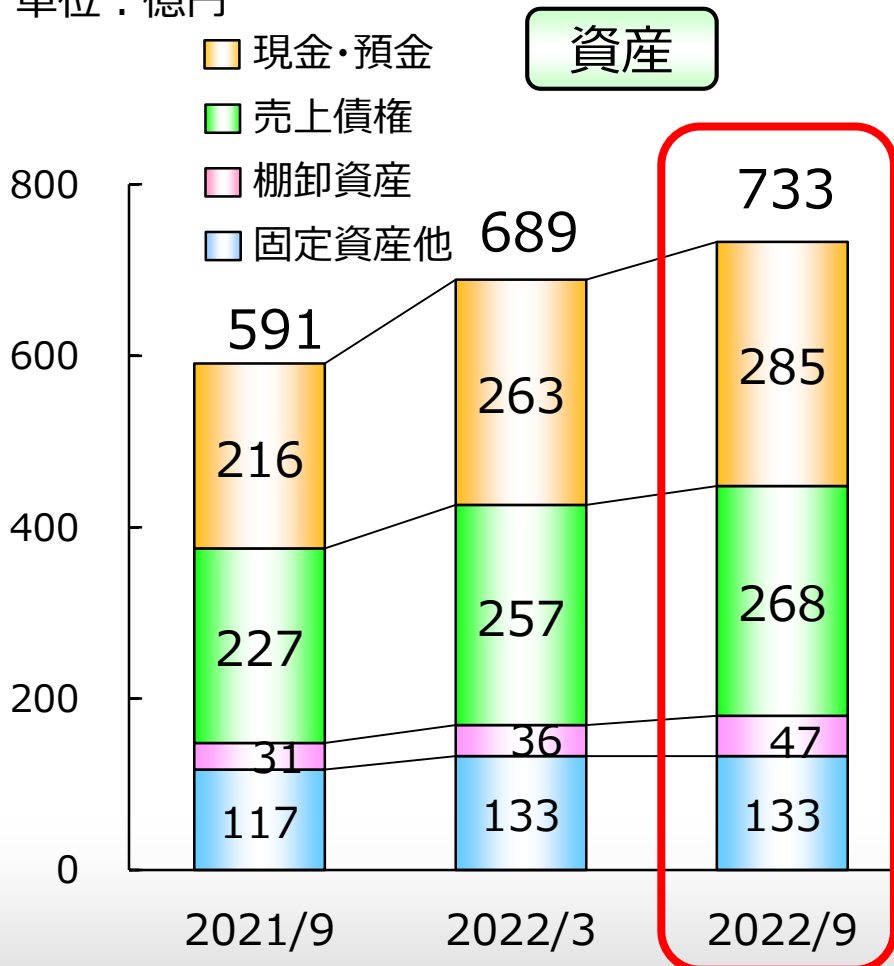


* 仕向地で区分

貸借対照表

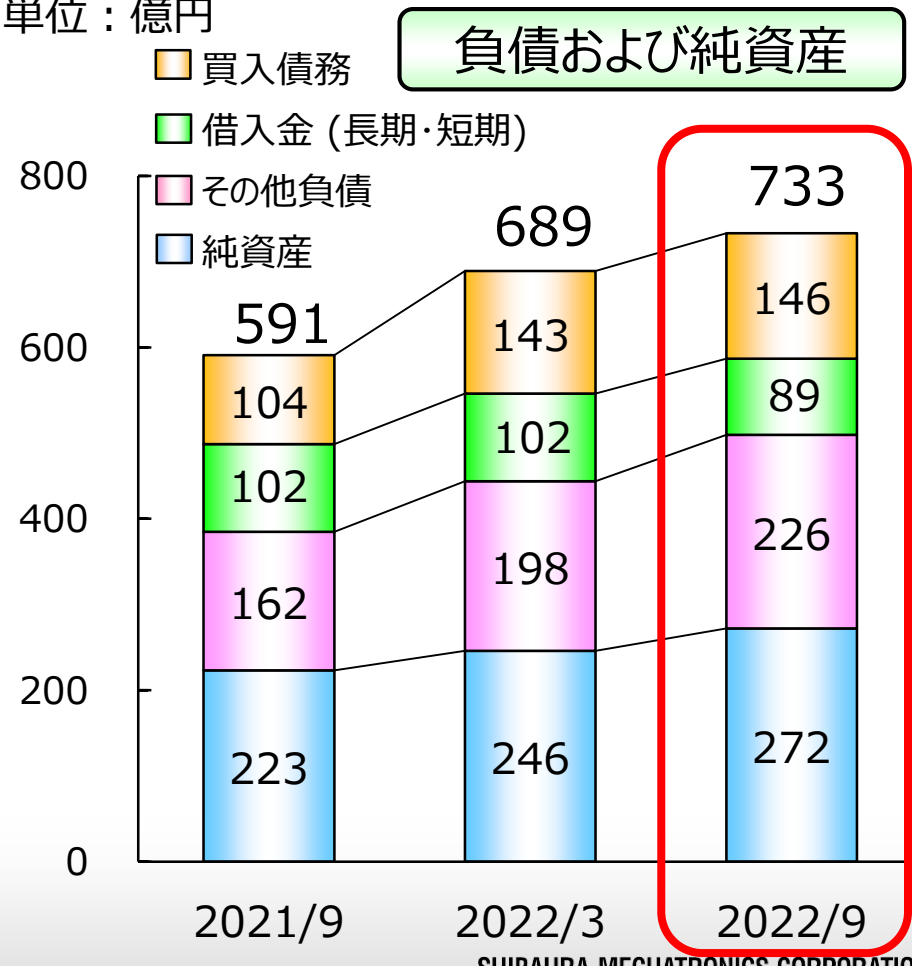
【連結】

単位：億円



自己資本比率 36% ('22/3) → 37% ('22/9)
D/Eレシオ 41% ('22/3) → 32% ('22/9)

単位：億円



目次

1. 2023年3月期 第2四半期業績
- 2. 2023年3月期 業績予想**
3. 中期経営計画の進捗

2022年度 業績予想 (1)

業績予想

【連結】

前回予想から売上高変更なし、
利益は上回る見込み

*1: 2022年8月公表

単位：億円

	2021年度			2022年度			前回予想 *1		2022年度
	21/上	21/下	2021年度	22/上実績	22/下見通し	2022年度予想	22/上見通し	22/下見通し	
売上高	219	274	493	293	267	560	280	280	560
営業利益	18.5	32.0	50.5	46.0	30.0	76.0	37.0	30.0	67.0
R O S	8.4%	11.7%	10.3%	15.7%	11.2%	13.6%	13.2%	10.7%	12.0%
経常利益	17.5	31.3	48.8	42.6	29.4	72.0	35.0	30.0	65.0
特別損失	6.1	-	6.1	-	-	-	-	-	-
当期純利益	7.5	22.3	29.8	34.1	23.9	58.0	28.0	23.0	51.0
R O E	-	-	12.8%	-	-	21.4%	-	-	19.1%
配当	-	-	230円	-	-	390円	-	-	350円
F C F	30.8	47.1	77.9	43.8	0	43.8	-	-	15.0

配当予想

当社は、連結配当性向をおおむね30%を目途としています。
2022年度 業績予想の上方修正に伴い、期末配当は、
40円増配の390円を予定しています。

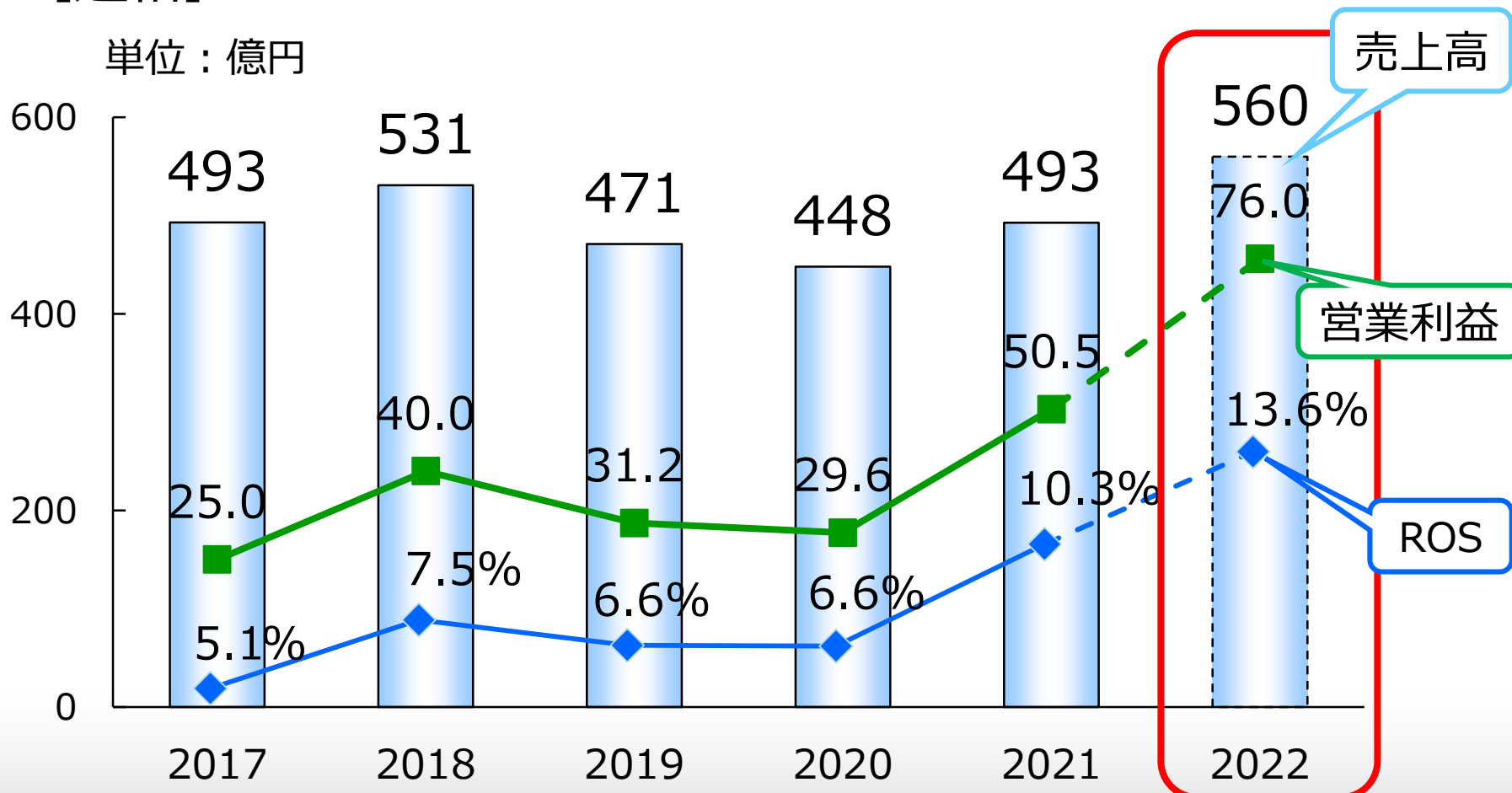
	第2四半期末 配当	期末配当	年間配当
今回予想 (2023年3月期)	0円	390円	390円
前回予想 (2023年3月期)	0円	350円	350円

売上高・利益・ROS

增收増益

【連結】

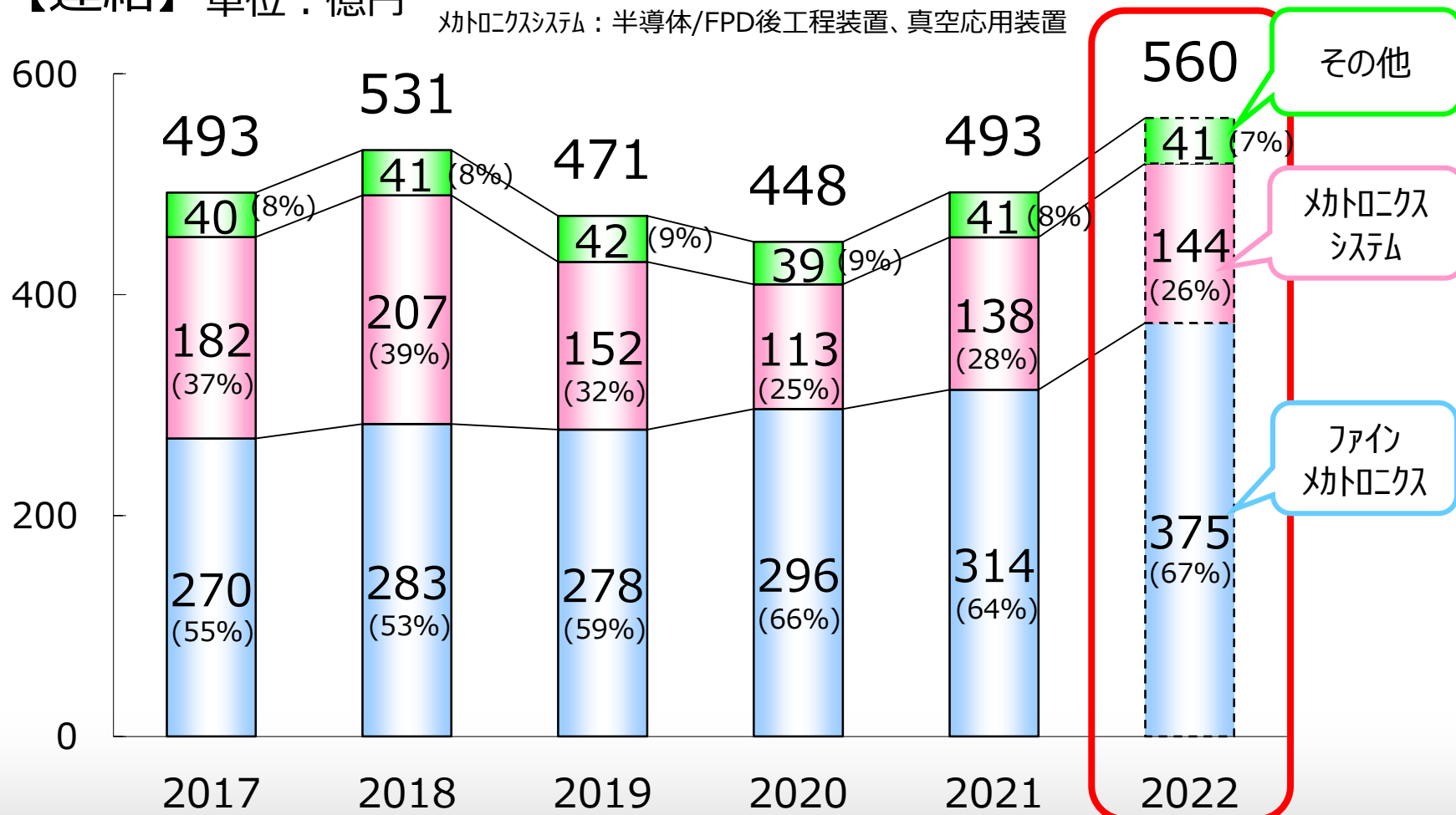
単位：億円



セグメント別売上高

ファインメカトロニクスが67%

【連結】 単位：億円 * ファインメカトロニクス：半導体/FPD前工程装置
メカトロニクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

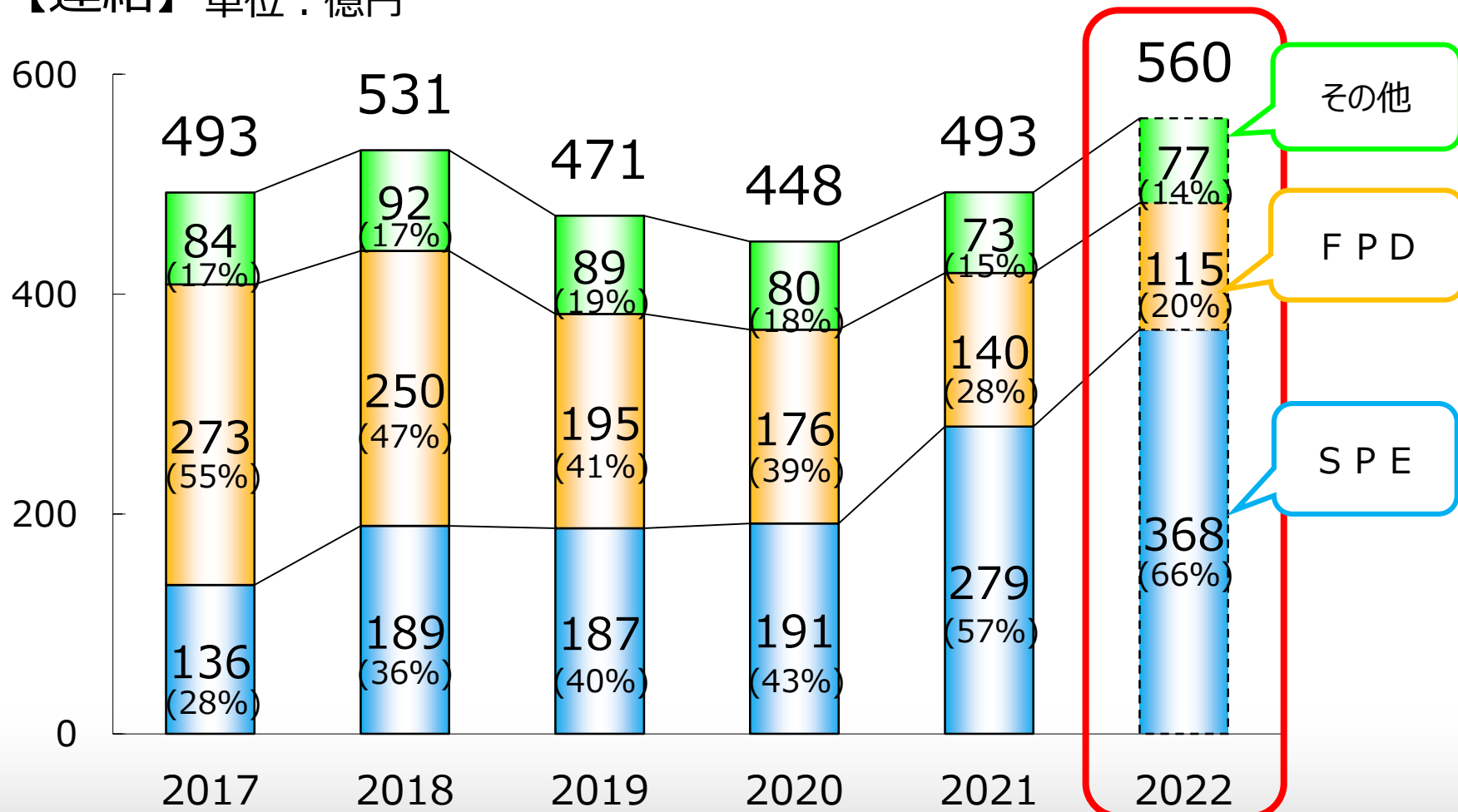


分野別売上高

SPE分野が66%

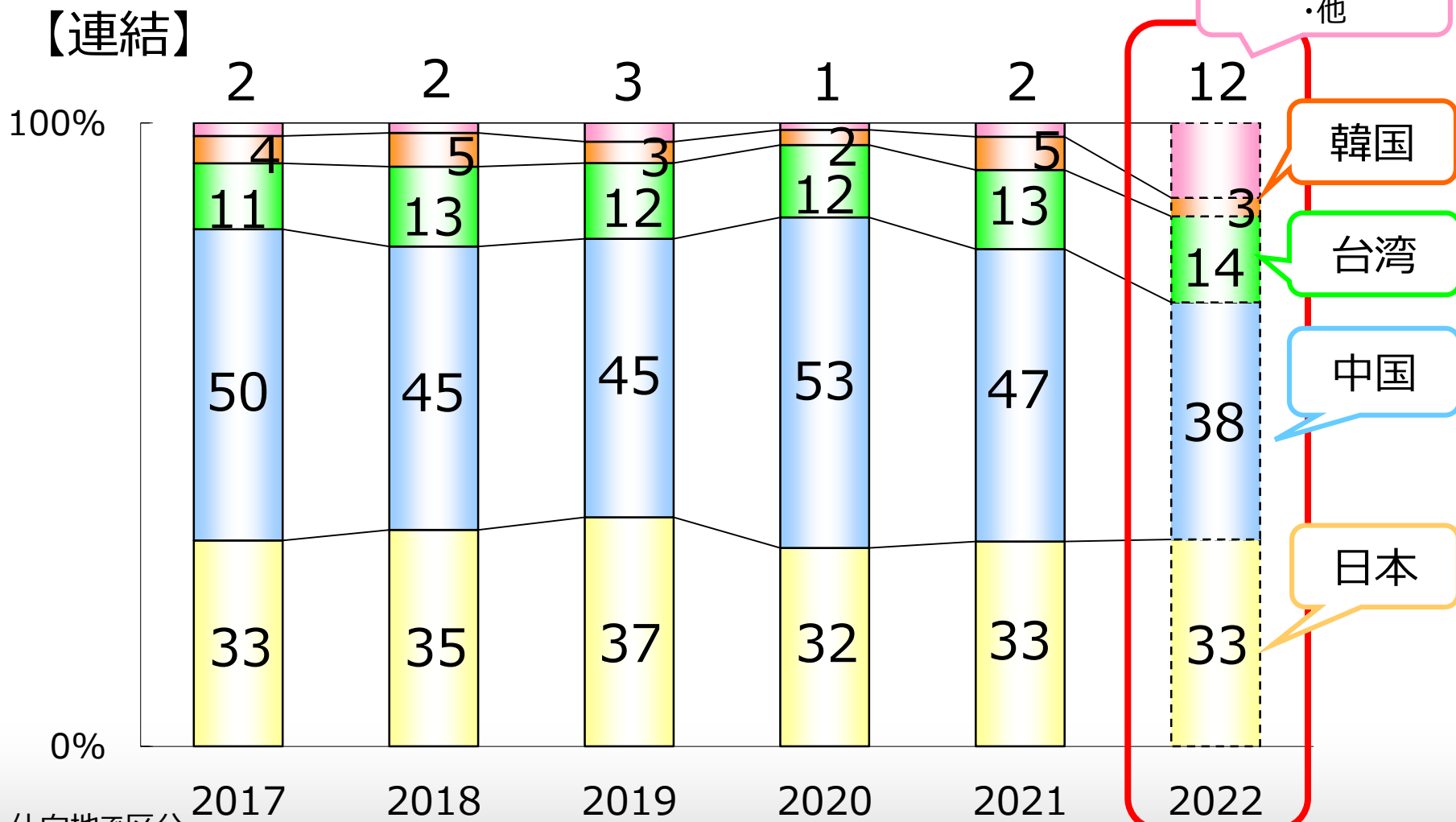
* SPE : 半導体前・後工程装置
FPD : FPD前・後工程装置

【連結】 単位：億円



地域別売上高比率

海外向け67% (中国38%)



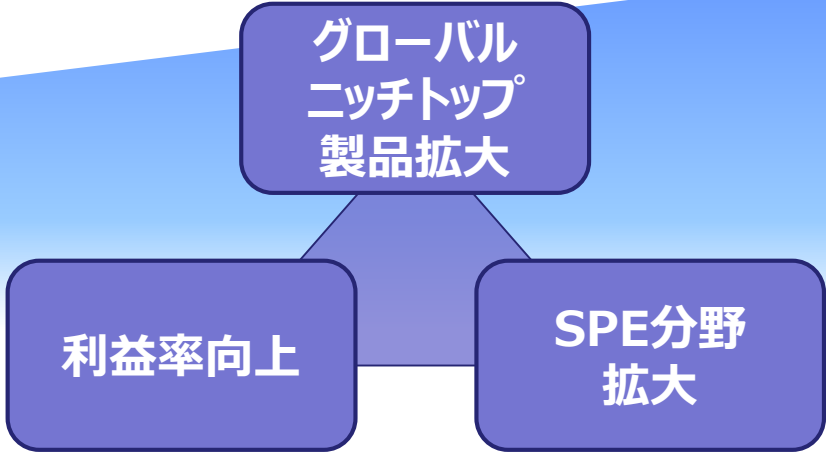
* 仕向地で区分

目次

1. 2023年3月期 第2四半期業績
2. 2023年3月期 業績予想
- 3. 中期経営計画の進捗**



SPE



FPD

これからのありたい姿

- ◆ IoT、5G、AIと、これから更に広がるデータ社会に向けて、半導体・FPD製造装置を通じた先端技術で貢献 ～「ものづくり」から「価値づくり」～
- ◆ SPE分野でグローバルニッチトップ、FPD分野で主要サプライヤとして存在感を示せる企業グループへと成長

中期経営計画の進捗

【連結】

2022年度は中計目標の
売上・利益を上回る

*1: 2020年11月公表

単位：億円

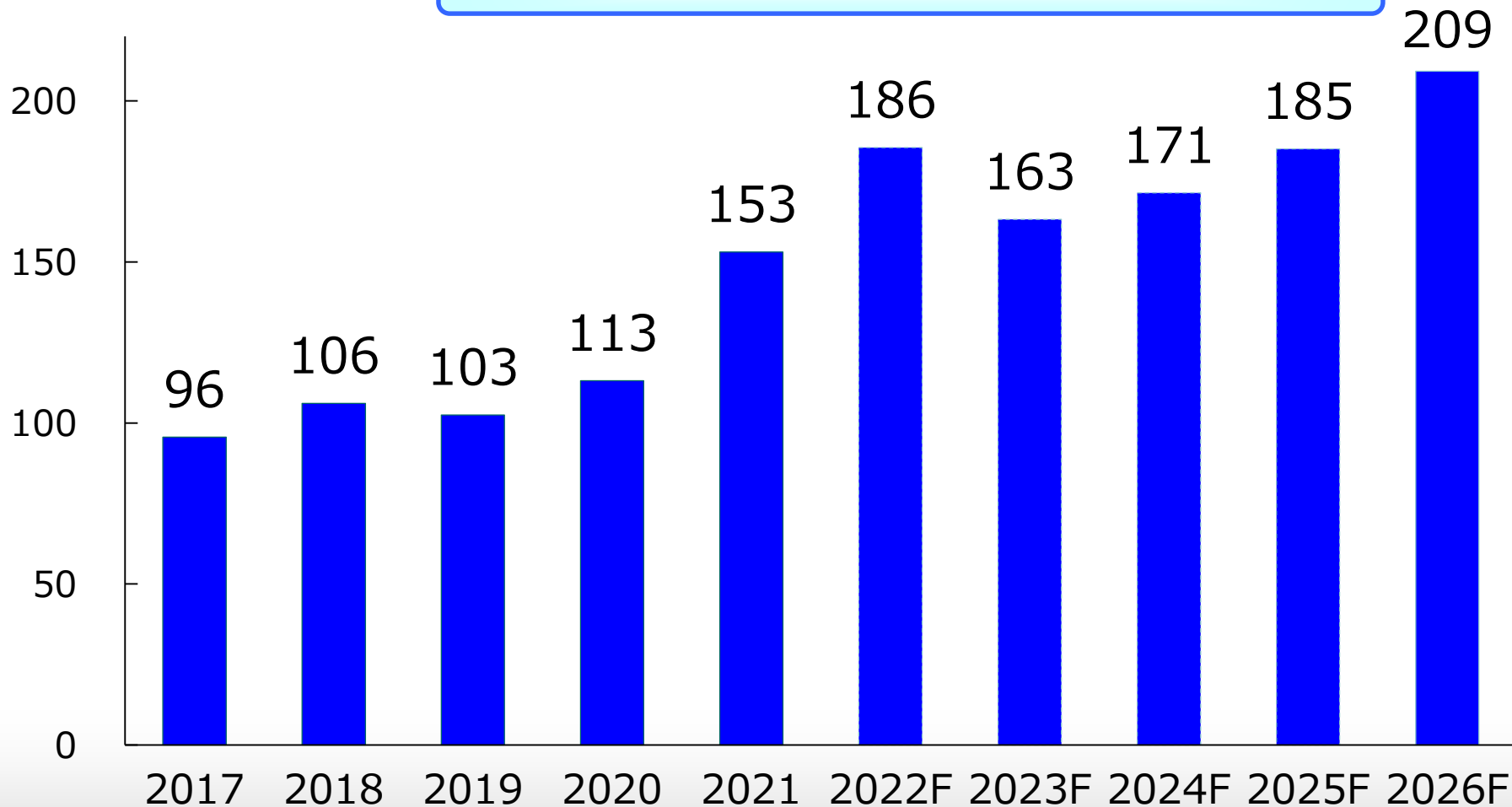
	2020	2021	2022	中期経営計画年度目標 *1		
	年度実績	年度実績	年度予想	2020	2021	2022
売上高	448	493	560	460	480	510
営業利益	29.6	50.5	76.0	30.0	38.5	51.0
R O S	6.6%	10.3%	13.6%	6.5%	8.0%	10.0%
経常利益	28.2	48.8	72.0	-	-	-
当期純利益	19.7	29.8	58.0	-	-	-
R O E	9.5%	12.8%	21.4%	9.5%	11.5%	13.0%

半導体工場・設備 投資高予測

* 出典：IC Insights 2022-8
当社にてグラフ作成

単位：10億US \$

2019 – 2022CAGR：21.9% (半年前予測では22.9%)



当社の事業環境

- IoT、5G、AIの発展で半導体需要拡大が期待されるが、スマホ、PC、TVの需要減速で設備投資に懸念
米国の対中国輸出規制強化に伴う動向等も継続注視

現在の当社の事業環境は、受注面からみると

- ✓ SPE前工程
 - ・市場は一時的にブレーキがかかるがロジック、Siウェーハ、パワーデバイス、いずれも中期的に投資継続
- ✓ SPE後工程
 - ・先端パッケージ向け投資は堅調に推移
 - ・フュージョン接合に関する問合せ旺盛

当中期経営計画グローバル ニッチトップ対象製品群

工程	対象装置	主な対象製品等
Siウェーハ製造	枚葉式洗浄装置	300mmウェーハ (プライム、再生)
フォトマスク製造	<ul style="list-style-type: none"> ・エッチング装置 ・枚葉式洗浄装置 	EUV用 blanks・マスク PSM用 blanks・マスク
ウェーハプロセス	枚葉式リン酸エッチング装置	ロジック/ファウンドリ
モジュールプロセス	高精度フリップチップボンダ	FO-WLP/PLP、2.5D、 CoWフュージョンボンディング

Siウェーハ製造／ウェーハプロセス事例

GNT

当中期経営計画
グローバル ニッチトップ
対象製品群

GNT



枚葉式Siウェーハ洗浄装置
(SC300 Series)

<特長>

- ・枚葉式による高洗浄度対応
- ・マルチチャンバ化による高生産性対応
- ・CMP装置との豊富なインライン接続実績

<展開>

- ・枚葉式洗浄で世界シェア No.1
- ・大手メーカーや新興国向け採用増、引続き受注好調で引合い案件拡大中

GNT



枚葉式リン酸エッチング装置
(SC300-HT Series)

<特長>

- ・エッチングレートの精密制御、低パーティクル
- ・次世代乾燥技術
- ・3 nm以降の次世代プロセス対応

<展開>

- ・大手ファウンドリでの実績をベースに受注拡大
- ・リン酸エッチングのアプリケーション拡大

モジュールプロセス – 高精度フリップチップボンダ事例

GNT



先端パッケージボンダ
(TFC-6500)

<特長>

- ・2.5Dパッケージ用途はじめ、マイクロバンプの接合に適用
- ・±1 μm の高精度を実現
- ・清浄度：クラス100相当

<展開>

- ・大手ファウンドリ、デバイスメーカー、OSATより継続受注
- ・車載関連、シリコンフォトニクス分野など用途拡大
- ・多様なプロセスに適応

GNT



フュージョンボンダ
(TFC-6700)

<特長>

- ・CoWチップレットに対応するフュージョンボンダ
- ・±0.2 μm の超高精度を実現
- ・清浄度：クラス1相当

<展開>

- ・ロジック半導体、メモリ、CISなど多分野へ展開中
- ・複数顧客への出荷実績
- ・量産化市場展開を見定めた製品開発を継続

グローバルニッチトップ製品を核としたSPEの拡大

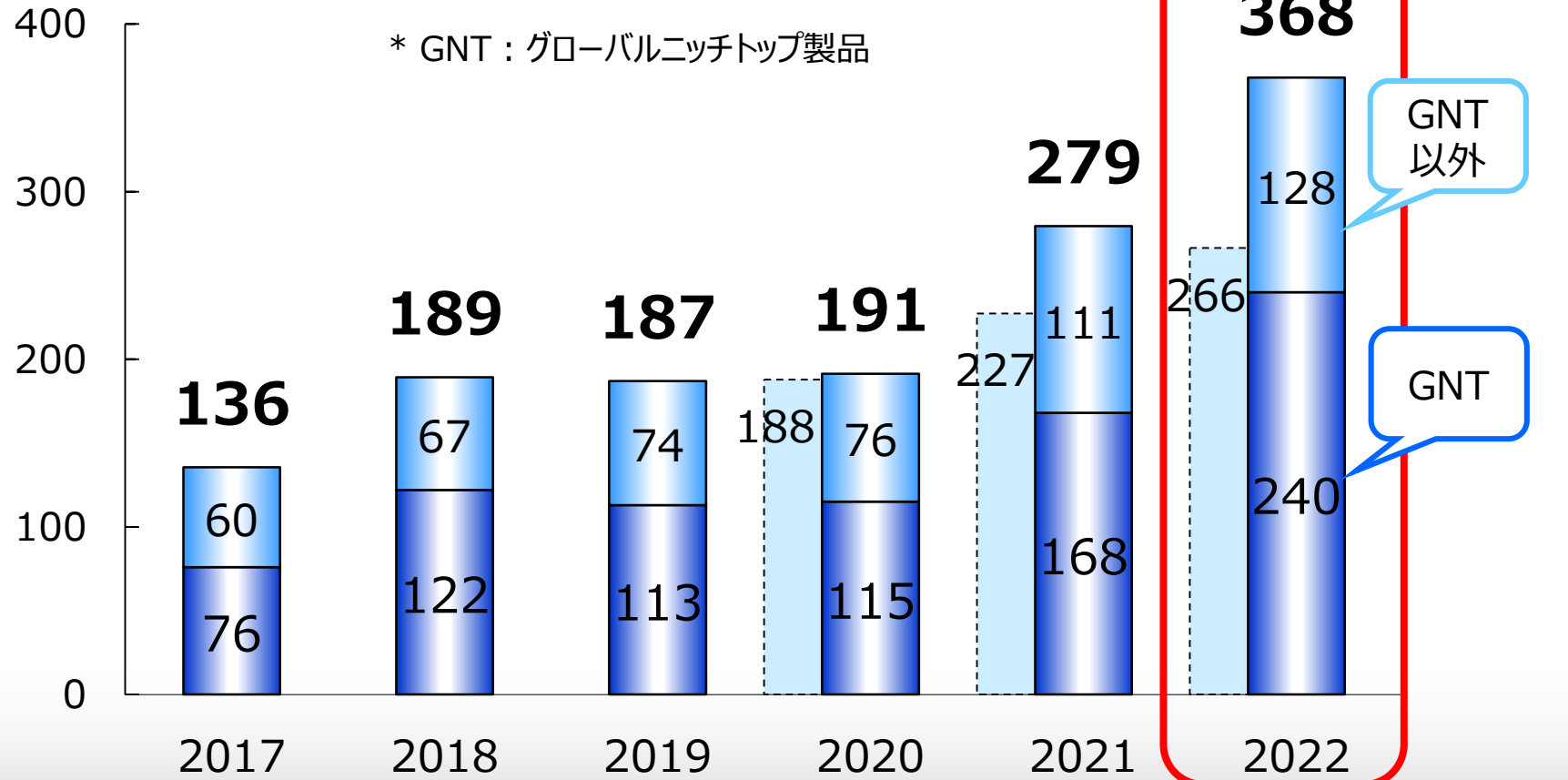
【連結】

単位：億円

■ '20-'22中期経営計画
(2020/11/5公表)

■ '17-'21実績、'22予想

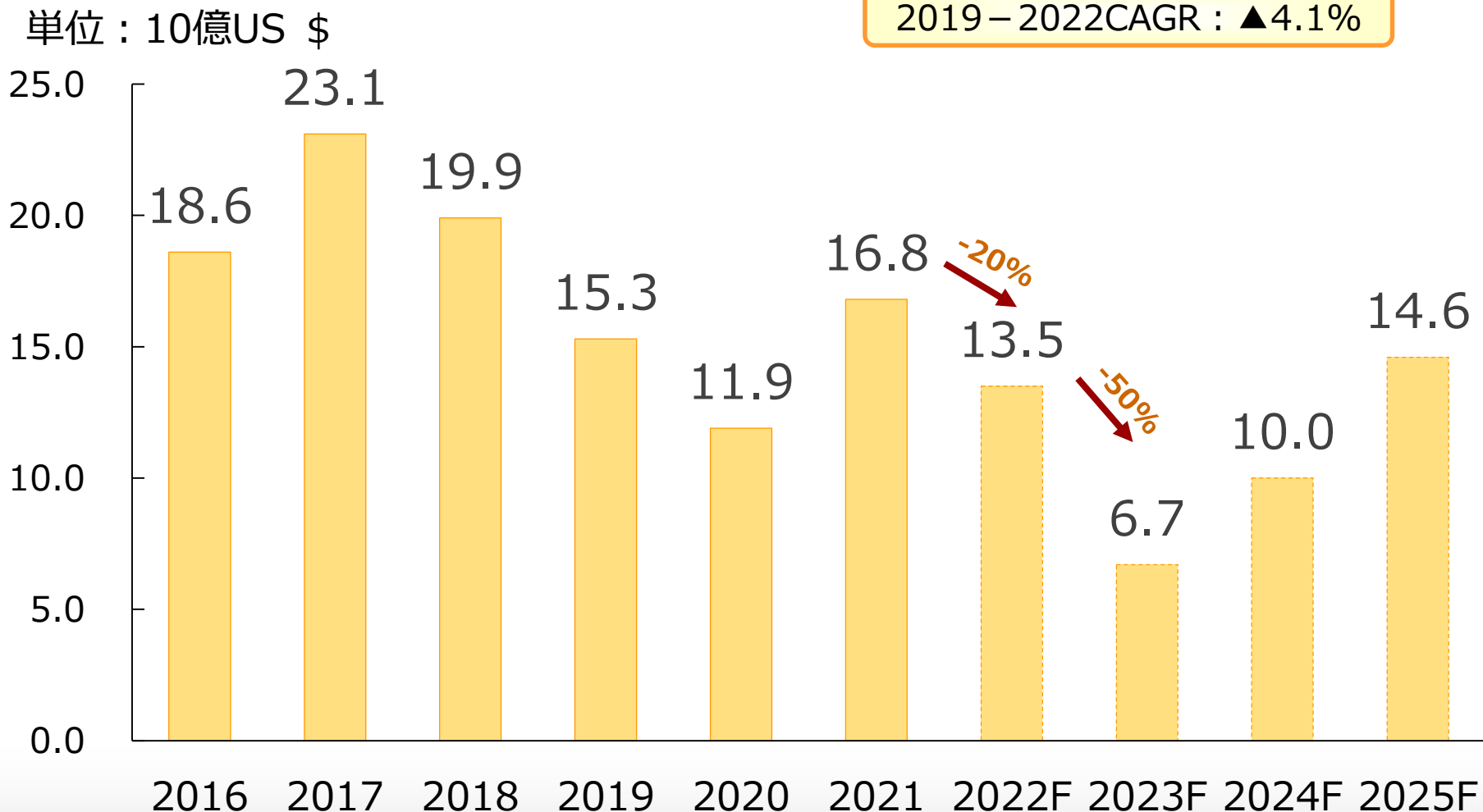
* GNT：グローバルニッチトップ製品



設備投資高予測

* 出典：DSCC 2022-10
当社にてグラフ作成

2019 – 2022CAGR : ▲4.1%



当社の事業環境

同様に受注面からみると

- ✓ FPD前工程
 - ・全体的なFPD需要の落込みが想定以上に長期化
 - ・パネルメーカーは大規模な生産稼働調整
 - ・設備投資計画も先送り傾向で、時期が流動的
- ✓ FPD後工程
 - ・TV、ITパネルは需要減により設備投資計画が延期、中止もあり流動的
 - ・車載パネルは投資堅調

FPD新規製品事例



中型OLB
(TTO-H3000M)

<特長>

- ・幅広い適用パネルサイズと高精度技術の融合で多様な市場ニーズに対応
- ・高い生産性と安定稼働

<展開>

- ・大手パネルメーカーからの受注継続
- ・大型化が進み投資も堅調な車載市場でのシェア拡大を図る

ヘルスケア製品事例



インクジェット錠剤印刷装置
(TIE-9000P/TIE-4500P)

<特長>

- ・当社コア技術(IJ)を応用
- ・高速、高精細印字
- ・錠剤外観検査機能のオプション対応が可能
- ・インクの自社開発、製造販売

<展開>

- ・大手製薬メーカーから継続した受注を獲得
- ・インクジェット錠剤印刷需要の高まりに期待

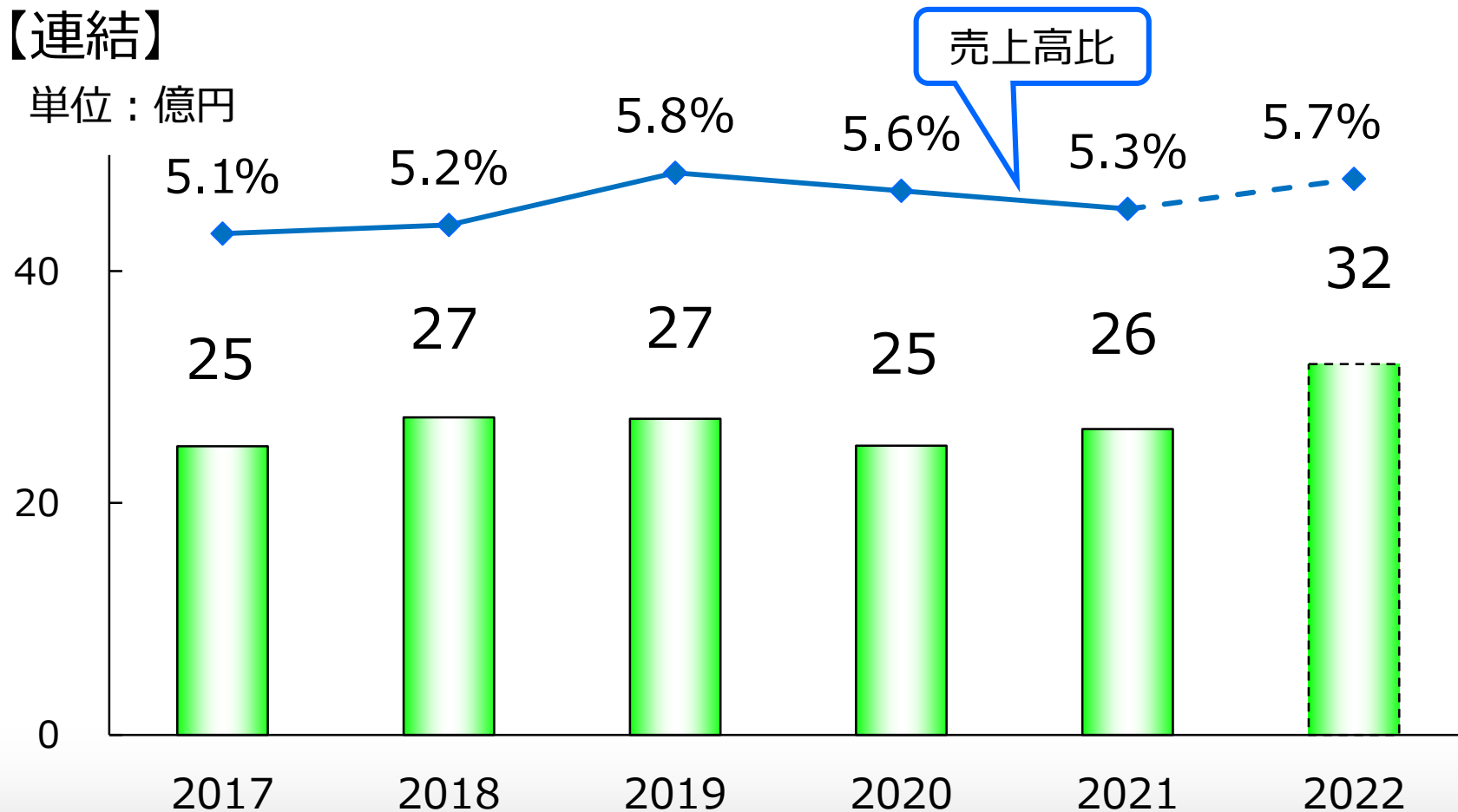
* インクジェット錠剤印刷装置：
ファインメカトロニクス部門FPD前工程分野に含む

研究開発費

SPE分野の開発加速

【連結】

単位：億円



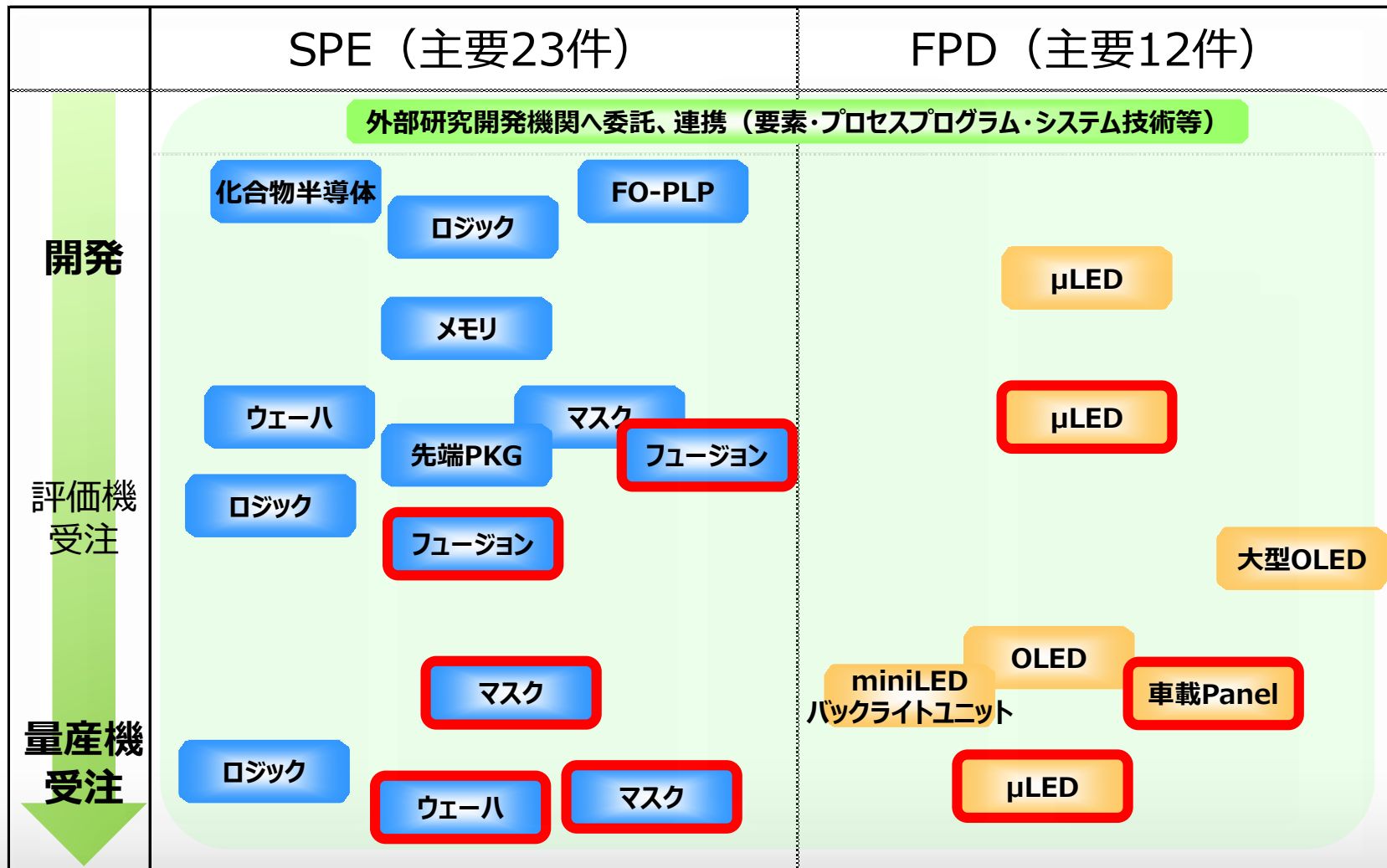
他社との連携 ①

* imec : Interuniversity Microelectronics Centre

- 装置メーカー、材料メーカー、デバイスメーカー、研究所や大学等と連携し、強い製品をよりスピーディに開発
imec 半導体プロセスプログラムを活用した開発進行中
- 主な株主（株式会社 東芝、信越エンジニアリング株式会社、株式会社 ニューフレアテクノロジー）と連携
- 主要各テーマも着実に進行中

他社との連携 ②

* 同じテーマ目つ進捗が同程度の複数案件は纏めて表示

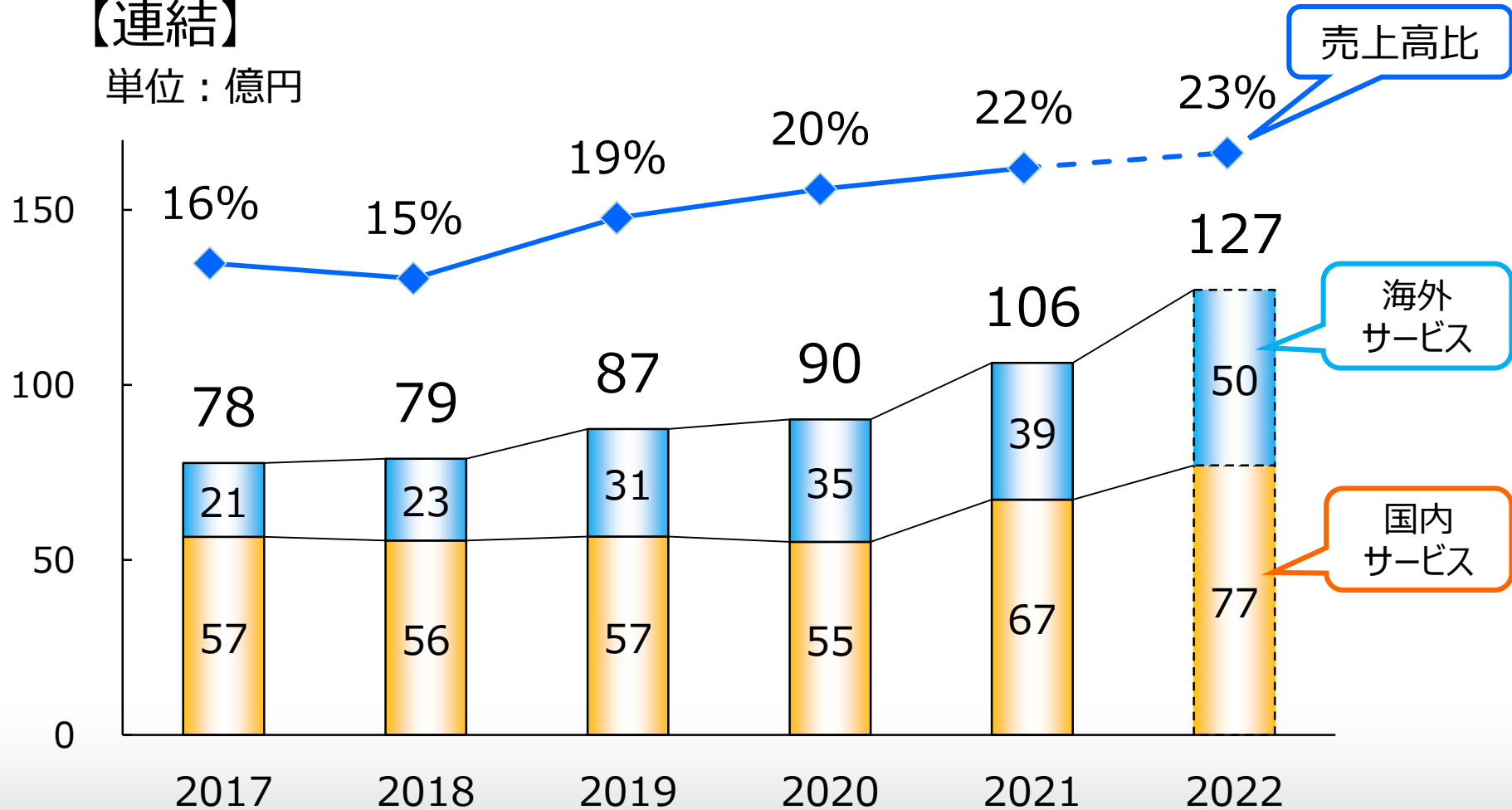


サービス事業売上高

中計目標どおり進捗

【連結】

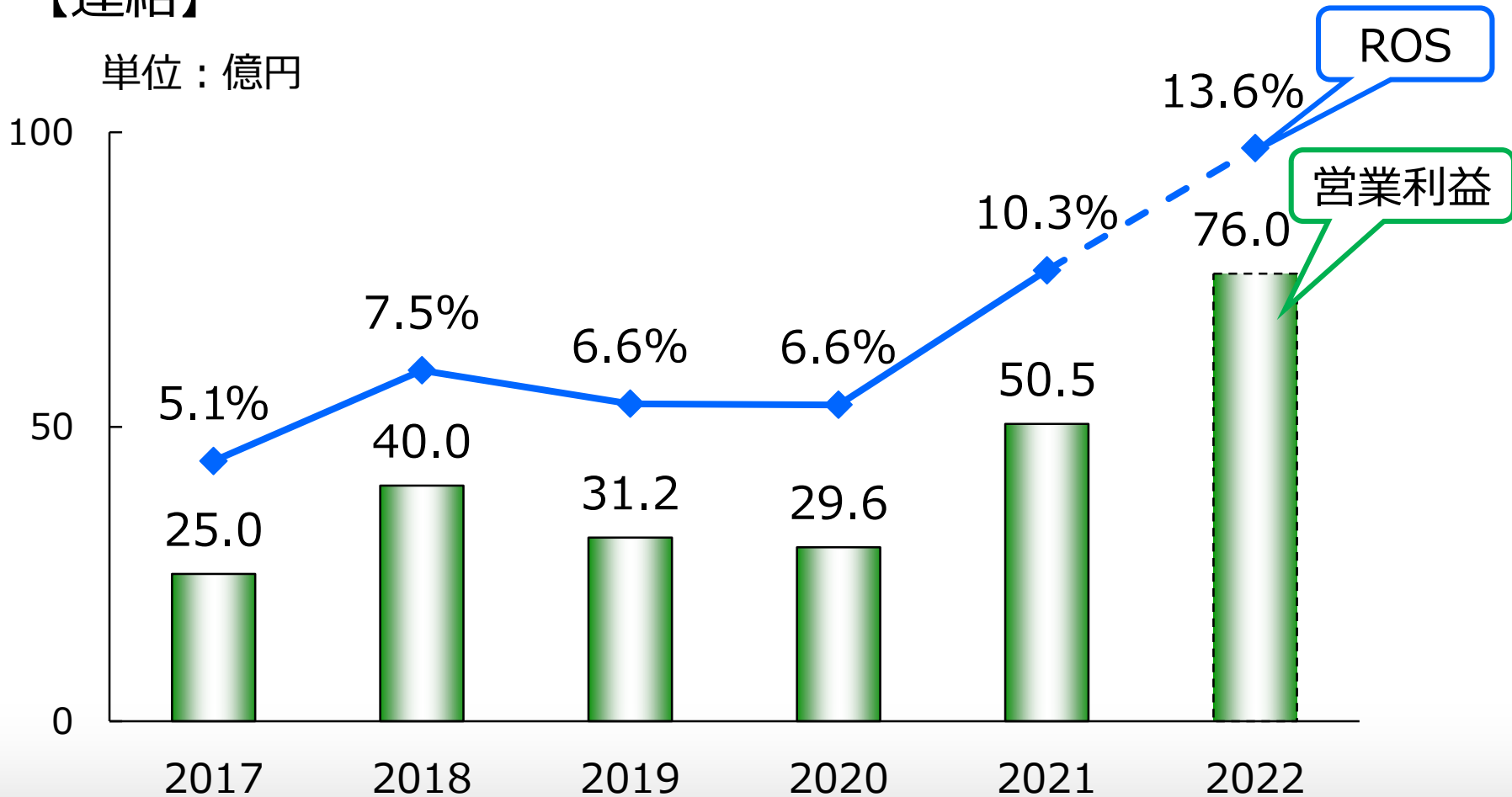
単位：億円



ROS改善

【連結】

単位：億円



SPE分野など高付加価値製品を拡大
ROSが大きく改善し13.6%

これまでのCSR活動を発展させ、サステナビリティの取組みへ

- サステナビリティ委員会を設置（CSR委員会から発展）
- サステナビリティ方針を制定
- 取り組むべきマテリアリティ（重要課題）を特定



Smart Solutions & Services for Your Manufacturing

「Smart」「Solutions」「Services」の3つの「S」で
お客様のものづくりに貢献してまいります。

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご了承願います。

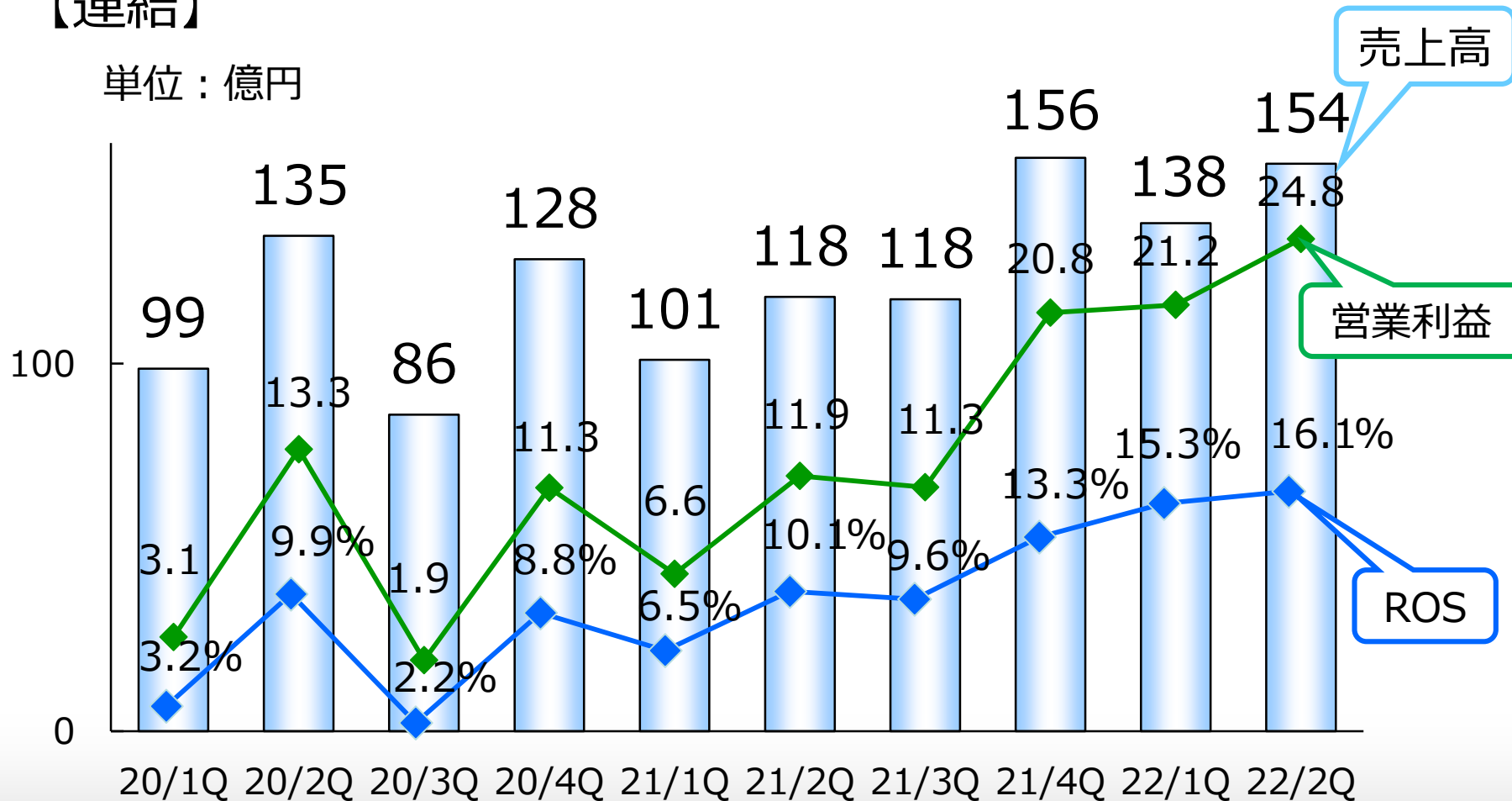
END

Appendix

売上高・利益・ROS

【連結】

単位：億円



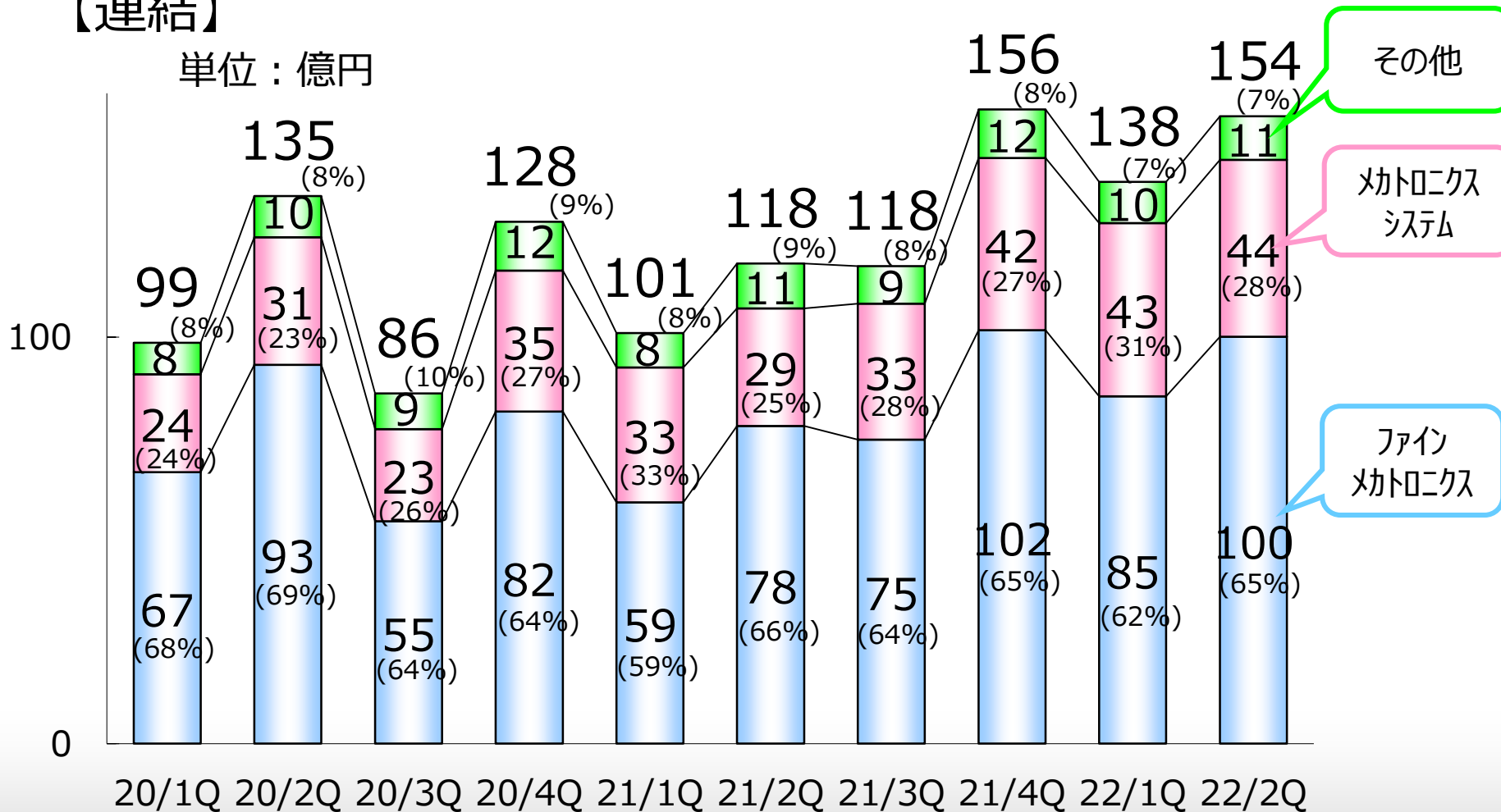
セグメント別売上高

* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置

メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

【連結】

単位：億円



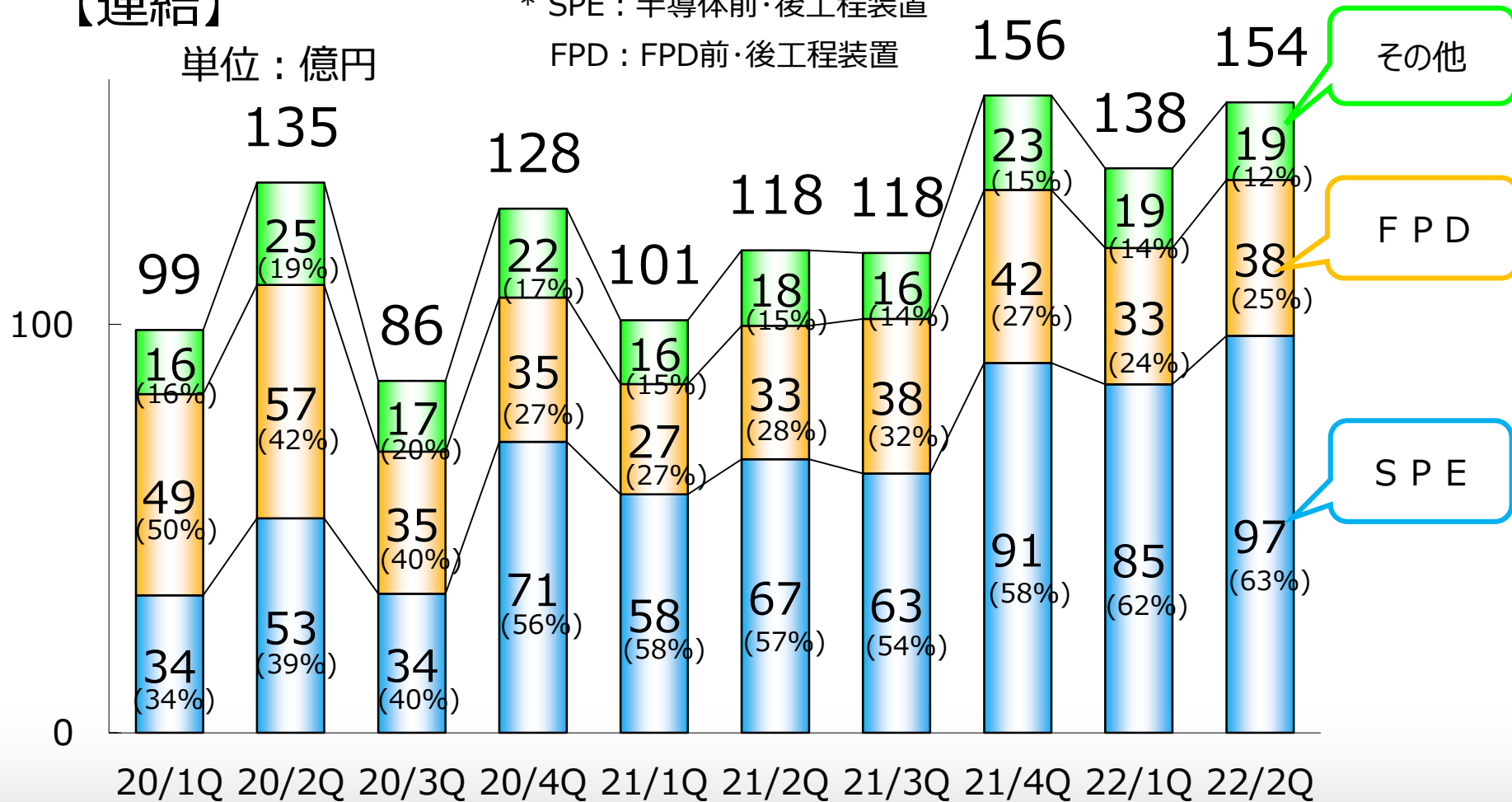
分野別売上高

【連結】

単位：億円

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置



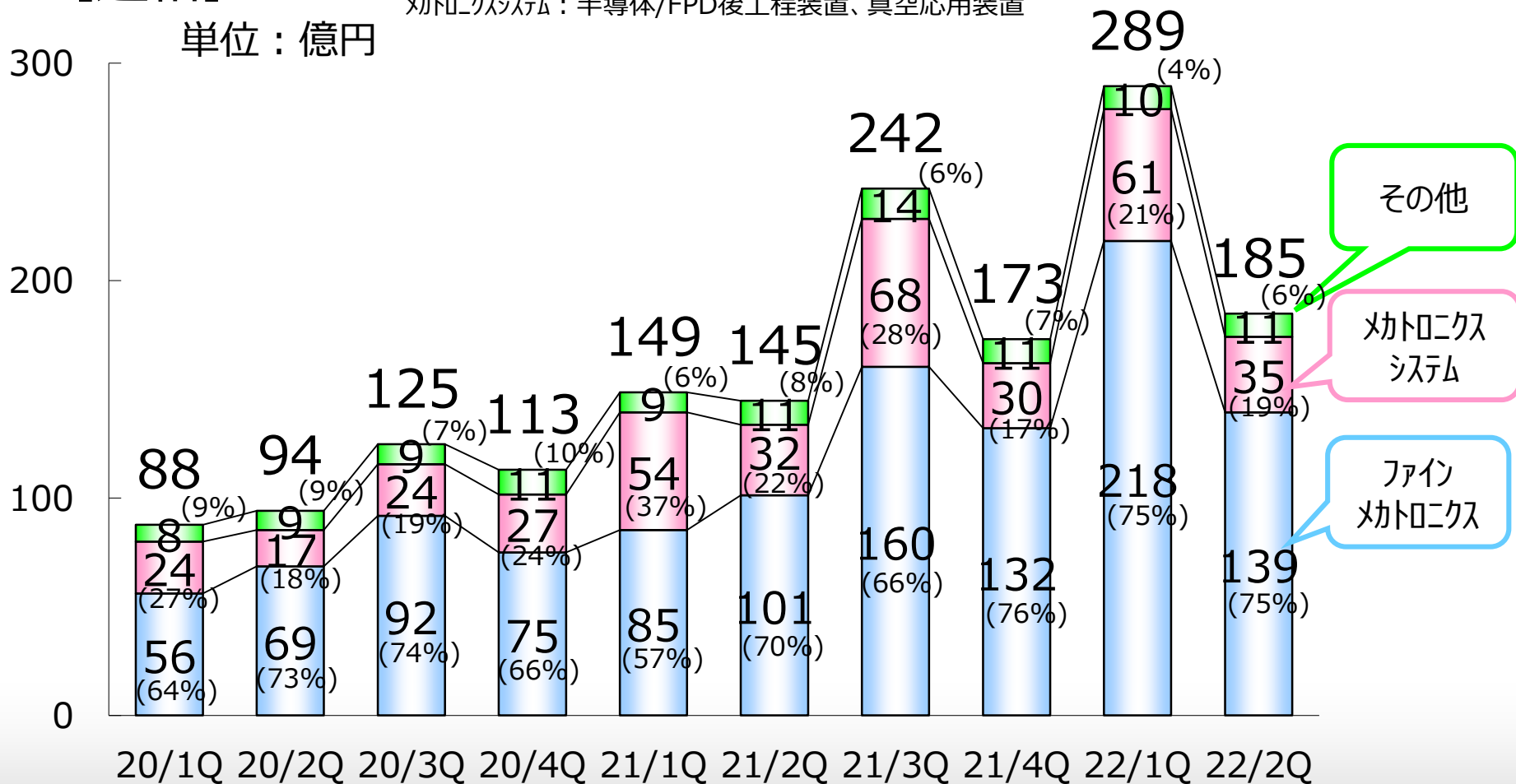
セグメント別受注高

【連結】

* ファインメトロクス：半導体/FPD前工程装置

メトロクスシステム：半導体/FPD後工程装置、真空応用装置

単位：億円



分野別受注高

【連結】

単位：億円

* SPE : 半導体前・後工程装置

FPD : FPD前・後工程装置

